

2026年度 産応協対話交流会セミナー
(共催：特定非営利活動法人CAE懇話会、大阪成蹊大学)

AI・最適化が切り拓く 設計とものづくりの未来

AI、最適化を活用した構造設計、材料開発について、
最新の計算機活用技術動向をお届けします。

2026. **9.4 金**
10:00-17:00 開場 9:30

スーパーコンピューティング技術産業応用協議会（産応協/ ICSCP）では、産業界におけるスーパーコンピューティング技術（パソコンからスパコンまでを対象にした数値シミュレーション技術およびHPC技術）の利活用促進を目的としてセミナーや講習会を開催しております。

今回はCAE懇話会および大阪成蹊大学との共催で、「AI・最適化が切り拓く設計とものづくりの未来」というテーマで対面・オンラインのハイブリッドセミナーを開催いたします。各分野の第一線でご活躍されている講師をお迎えし、ご講演をいただきます。セミナー後には交流会もご用意しております。最新の計算機活用技術動向を知る場として、また、交流の場としてご利用ください。ご多忙中とは存じますが、是非ご参加をご検討いただきますようご案内申し上げます。

2026年7月
スーパーコンピューティング技術産業応用協議会(産応協)/ICSCP

開催場所

大阪成蹊大学駅前キャンパス
3階301教室

対面/オンラインハイブリッド形式

大阪成蹊大学最寄駅：阪急電車京都線 相川駅 徒歩2分

申込

参加申し込みは以下URLから

[https://asas-sys.jp/seminar/register/
db0448ff1e423475ac979373502da52a0597be23](https://asas-sys.jp/seminar/register/db0448ff1e423475ac979373502da52a0597be23)

申込期限 8月28日(金)

※定員に達し次第締切

※当日、昼食時には学生食堂は営業しておりません。

ご持参頂くか、周囲の食堂やコンビニなどのご利用をお願い致します。

定員

対面 **70 名**

オンライン **100 名**

オンライン参加の方にはWebEXの招待状が開催2日前を目途にCAE懇話会より発信されます。

参加費

産応協正会員・準会員：**無料**

産応協登録会員・非会員：**7,000円**

※産応協登録会員 / 非会員へは、後日、参加費の請求書をお送り致しますのでお振込みをお願いします。

※セミナー後、交流会（飲食付）へのご参加は会員区分関係なく一律3,000円となります。

お問合せ先

スーパーコンピューティング技術産業応用協議会（産応協/ICSCP）事務局

〒112-0012 文京区大塚5-3-13 3F 学会支援機構内 Tel: 03-5981-6011、Fax: 03-5981-6012

受付時間（学会支援機構）：10:00～17:00（平日） Email: icscp@asas-mail.jp

AI・最適化が切り拓く設計とものづくりの未来

プログラム

CAE懇話会団体会員様講演

10:00

～

10:35

語りかける構造解析 — 操作手順を覚えず、自然言語で解く

自然言語で「やりたいこと」を伝えるだけで解析が進む「語りかける構造解析」を紹介します。複数のAIが役割を分担し、曖昧な指示を補いながら、多様な構造解析を支援する仕組みと開発状況を紹介します。

株式会社インサイト

三好 昭生

10:35

～

11:10

ADVENTUREClusterにおける生成AI活用

～AIによる設計・解析プロセスの自動化～

ADVENTUREClusterに生成AIを活用し、自然言語の指示だけでメッシュ生成、条件設定、結果の可視化、レポート作成までを自動化する取り組みを紹介します。

SCSK株式会社

横山 航希

11:10

～

11:45

AI×シミュレーションによるCAEの未来

-「Multi-Sigma」による設計・材料開発の超効率化-

AIとCAEを高度に融合する「Multi-Sigma」シリーズを活用し、製品設計・材料開発を効率化する新たな研究開発方法論を紹介します。

株式会社エイブス

河尻 耕太郎

一般講演

13:00

～

13:05

開会挨拶

13:05

～

14:00

機械学習を用いた離散構造の最適化

離散構造（骨組構造、トラス構造）の最適化のための機械学習の歴史、現状と将来展望を概説し、主に建築構造物を対象として、深層強化学習、特徴選択・抽出、生成モデルなどを用いた最適化例を紹介します。

京都大学名誉教授

立命館大学客員教授

大崎 純

14:00

～

14:55

AIIエージェントが拓くHPCコード最適化の新時代

AIIエージェントによるHPCコード最適化の新展開として、マルチエージェント最適化システム VibeCodeHPC、量子アニーラのパラメタチューニングとPythonコードからのC変換による高速化、および、今後の展開を紹介します。

名古屋大学

情報基盤センター

教授 片桐 孝洋

14:55

～

15:10

休憩 15分

15:10

～

16:05

材料科学における多様な探索問題のためのベイズ的最適化

材料関連分野においては物性の最適化などをはじめ、多様な探索問題が現れる。講演では単純な単一数値の最適化だけでなく様々な問題設定をベイズ的な機械学習モデルで扱う方法を紹介し、

名古屋工業大学

大学院工学研究科

教授 烏山 昌幸

16:05

～

17:00

AI・CAEで拓く歯科材料開発

亀裂進展を評価した事例を紹介する。さらに、AIを活用して組成から曲げ強さを予測し、高強度発現が期待される材料組成を効率的に絞り込んだ事例を交え、AIとCAEを融合した歯科材料開発の可能性を展望します。

大阪大学

大学院歯学研究科

教授 山口 哲

17:00

～

17:10

閉会挨拶

17:15

～

18:30

交流会

会場：大阪成蹊大学駅前キャンパス8F食堂
参加費用：3,000円（税込）飲食付
参加ご希望の方は、登録時にお申込みください。